

TE Connectivity(TE)は、日々お客様に革新的な技術とノウハウを提供し、接続技術の将来の発展に寄与できるよう尽力しています。本アプリケーションガイドでは、お客様が抱えるさまざまな課題の解決のお手伝いをするTEの最新製品を紹介致します。

# 新製品

## アプリケーションガイド

2018年夏号

携帯用デバイス  
.....  
スマートホーム  
.....  
ソリッドステートライティング  
.....  
インテリジェントビルディング  
.....  
VA(高付加価値)アセンブリ  
.....  
ファクトリーオートメーション  
.....  
データコミュニケーション  
.....  
過酷な環境向けソリューション  
.....  
常時接続に必要なパワーを提供  
.....

携帯用

# デバイス

より持ち運びやすく、また、より小型、軽量、薄型であること、このようなお客様のニーズが、急速に成長するエレクトロニクス産業に於いて一層高まっています。TEは絶え間ない技術革新により、様々な小型インターコネクト製品をラインアップしています。変わりゆく産業のトレンドやニーズに対応するTEの最新製品をぜひご活用ください。



a

## a. SpO<sub>2</sub> 光学コンポーネント

赤色LEDの波長公差が最大660nm±2nmで、高い精度を実現します。優れた信頼性と品質を提供します。



b

## b. MS5837-30BA 防水デジタル圧力センサ

超小型で高精度の出力により、デザインの柔軟性を高めます。耐磁性のゲル充填キャップで、太陽光や腐食性流体の侵入を防ぎます。

## c. ピッチ0.4mm、高さ0.7mmの基板対基板コネクタ

堅牢な構体で損傷の問題を低減します。複数の接点で信頼性を向上します。

## d. ブロックSIMおよびマイクロSDカードコネクタ

固定金属シェルなしで柔軟性とコスト効率を実現します。アンチバックリング(座屈防止)設計により、耐久性の向上に貢献します。



c

## e. 3 in 2カードコネクタ

カード挿抜時の損傷を防ぐ堅牢性に優れたソリューションを提供します。2枚のSIMカード、または1枚のSIMカードと1枚のマイクロSDカードを挿入できます。

## f. MS5837-02BA超小型ゲル充填圧力センサ

防水性能と13cmの高度分解能を備えています。超低消費電力で、高精度なデジタル24ビットの圧力値と温度値を実現します。

## g. センサ開発基板

圧力・温度・湿度センサの製品開発を促進し、ラピッドプロトタイプングに貢献します。Microchip Explorer 16、ARDUINO/Genuino、Grove、Raspberry Piの各種標準的なプラットフォームに対応します。



f



h

## h. 5A低背型バッテリー

ワンピース設計で信頼性を高め、接点の折損を防ぎます。5Aの電流容量で、高速充電に対応します。

## i. スプラッシュプルーフUSB Type-Cリセプタクル

オフセット0.65mmのミッドマウント2列SMTにより、省スペースを実現します。IPX4に適合する防滴設計で、過酷な環境のニーズに対応します。



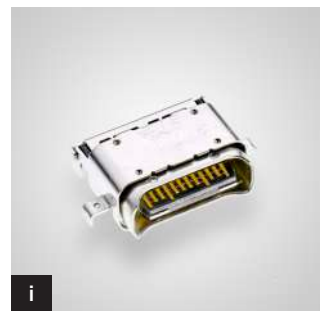
d



e



g



i

# スマート ホーム

世界的なエンジニアネットワークを持つTEは、お客様のスマートホーム用途のアイデアの実現を支援します。生活家電、照明、HVAC、セキュリティなど、幅広い接続ソリューションとセンサソリューションを持つTEは、お客様の製品の迅速な市場投入を支援する理想的なパートナーです。

## a. **AmbiMateセンサモジュール MS4シリーズ**

予め加工されたセンサソリューションを組み込むことによって、市場投入までの時間を短縮します。I<sup>2</sup>C通信プロトコルを使用して、AmbiMateセンサモジュールを簡単に統合できます。

## b. **2極LIGHT-N-LOKモジュラ型ラッチ付きコネクタ**

コンパクトな設計で省スペースを実現します。工具不要で、現場での取り付け時間を短縮します。

## c. **3極LIGHT-N-LOKモジュラ型ラッチ付きコネクタ**

コンパクトなサイズで、スペースを節約できます。Poke-inコンタクトにより、工具不要で簡単にすばやく取り付けることが可能です。

## d. **CoolSpliceコネクタ - 新しい標準シリーズと大径ワイヤシリーズ**

単線とより線に適したコネクタで、柔軟なソリューションを実現します。

## e. **Pushグリップワイヤコネクタ**

工具不要のPoke-inワイヤスプライスで、取り付けが簡単です。複数のワイヤゲージを単一スプライスで結線します。

## f. **SlimSealコネクタミニチュアシリーズ**

IP67定格コネクタで、シールドソリューションを実現します。ポジティブラッチ機構により、不慮のコネクタの不嵌合を防止します。

## g. **250シリーズMini FASTONリセプタクル**

狭い空間に収まる、ミニチュアサイズのストレート構成を採用しました。標準的な0.250 x 0.032インチ タブと嵌合します。

## h. **ツイストスプライスワイヤコネクタ**

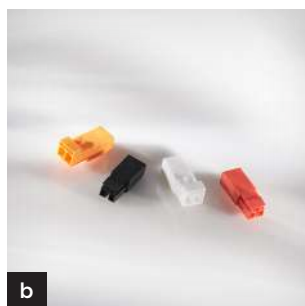
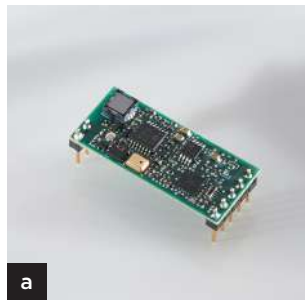
業界標準に従って色分けされたスプライスで、AWG22からAWG8までの電線を結線します。確実なグリップを実現する角パネにより、迅速・強固・確実な接続を保証します。

## i. **Poke-in薄型ワイヤコネクタ**

リリース機能により、すばやく再加工が可能です。高密度のPCBLレイアウトに適したコンパクトな設計で、省スペースを実現します。

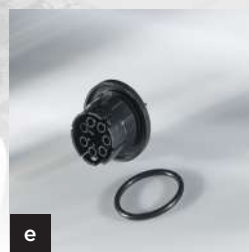
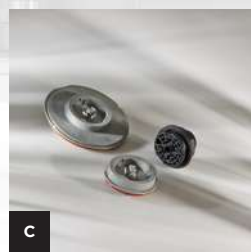
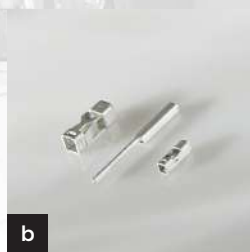
## j. **USB Type-Cリセプタクル**

単一の接続でデータ、電力、音声/ビデオ入力的高速伝送を実現します。リバーシブル設計により、簡単に確実な嵌合が可能です。



# ソリッドステート ライティング

TEは、次世代の固定照明(SSL)ソリューションの開発分野に於ける業界のリーディングカンパニーです。屋外の照明器具から業務用冷蔵庫まで、新技術が照明分野の技術革新の推進のお手伝いをします。新規システムの創造、既存設計の強化等を問わず、TEは広範囲にわたって新しい省エネルギーソリューションを提供します。



## a. LUMAWISE LEDホルダー タイプZ35

はんだ付けせずに接続が可能で、高レベルの統合を実現します。テープイン式LED保持機能により、LEDの組み立てをすばやく簡単に行えます。

## b. Poke-in薄型ワイヤコネクタ

リリース機能により、すばやい再加工が可能です。高密度のPCBレイアウトに適したコンパクトな設計で、省スペースを実現します。

## c. LUMAWISE Endurance S モデル

コンパクトサイズのモジュールで、照明器具設計の柔軟性を高めます。シーリングの改善により、取り付けねじを使用せずにIPx5またはIPx6を実現します。

## d. アースクリップケーブル アセンブリ

シンプルなクリップ設計により、すばやい取り付けが可能です。塗面や裸面、アルミパネルやステンレスパネルに対応し、アプリケーションの柔軟性を高めます。

## e. NECTOR Mパワーシステム PCBパネルマウント

PCBとパネルを接続するIP67コネクタソリューションを実現します。直径25mmの7極ソリューションで、スペースを節約できます。

## f. LUMAWISEドライブLED ホルダータイプZ50

オンボードドライバ採用のソリューションにより、エレガントな照明デザインを可能にします。  
19×19mm、20×24mm、  
16×19mm、24×24mmサイズの  
CoBへの熱および電気接続に  
対応します。

## g. BUCHANAN WireMate コネクタサーフェスマウント型 TBシリーズ

表面実装ターミナルブロックにより、リフローはんだ付けが簡単で、すばやくPCBの組み立てが可能です。SMT保持機能で、PCBを確実に取り付けられます。

## h. LUMAWISE写真制御ベース とカバー

電力と信号インタフェースを調光リセプタクルに一体化して、長期信頼性を確保する、TEのトータルソリューションです。過酷な環境にも耐えられる、持続性のあるソリューションを実現します。

## i. SlimSealコネクタミニチュア シリーズヘッド

ポジティブラッチ機能により、コネクタの不慮の不嵌合を防止します。IP67に適合するコネクタで、防塵・防水用途向けの理想的なソリューションを実現します。

## j. LUMAWISE Endurance N 高機能ベース

構造化されたDC電源と信号方式のインタフェースにより、費用対効果の高い設計の再使用を実現します。新しいプロジェクトの機会に伴うサプライチェーンの経費を削減し、認証およびエンジニアリングのコストを削減します。

# インテリジェント ビルディング

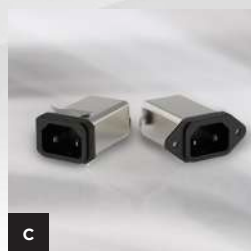
今日の建物はますます効率化され、建物にはさまざまなケーブル接続が使用されています。TEはお客様の複雑な接続に関する課題の解決をお手伝いすべく多くのソリューションを提供しています。弊社の新製品は、制御装置のシームレス統合を実現し、環境及び照明の制御から人の流れ、各種サービス機器に至る複数のビルシステム全体に電力とデータを確実に伝えることにより、より安全で確実な住居・作業空間を提供致します。



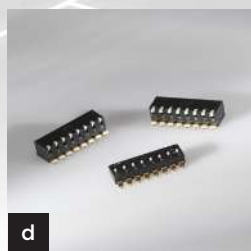
a



b



c



d



e

## a. プラチナ温度センサ

-200~+600℃の極限温度環境で高い精度を実現します。線形に近い出力で、設計の効率の向上に貢献します。

## b. ALCOSWITCH耐破損押しボタンスイッチ

大きな押しボタンで使いやすいユーザインタフェースを実現し、LEDインジケータでスイッチを点灯します。スポット、リング、パワーロゴを含むさまざまな押しボタン記号により、柔軟性を高めます。

## c. Corcom IECインレットRFIフィルタIHシリーズ

IEC 60601に準拠したフィルタにより、IEC 60601の漏れ電流の要件を満たします。V-Lockコードにより、装置の偶発的な電源切断を防ぎます。

## d. ALCOSWITCH DIPスイッチ EDS/EDSPシリーズ

エンドスタックプル機能により中心線を維持しながら、PCBで省スペースを実現します。拡張またはフラッシュアクチュエータにより、設計の柔軟性を高めます。

## e. TPA付きスタンダードパワータイマーハウジング

さまざまなアプリケーションでプリント基板への一次電源供給をサポートします。それぞれ結線するよりも迅速に組み立てることが可能で、より作業性の良いソリューションを実現します。

## f. パワートリプルロックPCBヘッダ

3重のロック機構を提供する新しいコネクタ用ヘッダで、電線対基板オプションを拡大します。ライトアングルおよび水平タイプを選択でき、柔軟な設計が可能です。

## g. Potter & Brumfieldリレー T9Gシリーズ

クラス最小のリレーで、標準の設置面積を保持しながら、PCBのスペースを節約できます。UL、CQC、VDEの認証を取得しており、世界中どこでも利用可能なリレーソリューションです。

## h. ALCOSWITCH DIPスイッチ TDSシリーズ

3ステートポジショニングにより、セキュリティを高める独自のコーディング構成を実現します。拡張またはフラッシュアクチュエータにより、設計の柔軟性を高めます。

## i. Poke-in薄型ワイヤコネクタ

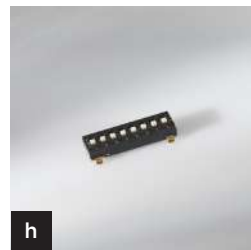
リリース機能により、すばやく再加工が可能です。高密度のPCBレイアウトに適したコンパクトな設計で、省スペースを実現します。



f



g



h

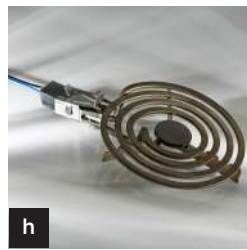
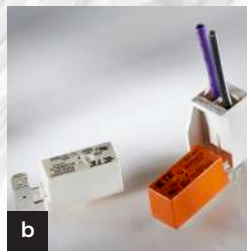


i

## VA(高付加価値)

# アセンブリ

システム間の接続性能は極めて重要です。弊社の専門知識、ノウハウによりお客様の設計の向上、効率化および費用の低減をお手伝いいたします。制御盤、電源システム、ケーブルアセンブリ、制御装置、タイマーまたはセンサを含む各種システム向けに、TE製品は幅広いソリューションを提供します。



**a. 0.110低背型ポジティブロックリセプタクルハウジング**

低背デザインにより、ガス点火装置の端子キャビティやシュラウドに収まります。リセプタクルを中央に配置したハウジング設計により、簡単に適切な嵌合を実現します。

**b. RFリレー用2極ポジティブロックリセプタクルハウジング**

2つの同時接続が可能な2極ハウジングにより、最終製品の組立工程を促進します。リセプタクルを軽い力で挿入でき、組み立てが容易です。

**c. 厚さの異なるタブに対応した4.8 FASTONリセプタクル**

厚さ0.5または0.8mmのタブとの嵌合が可能です。0.5~2.5mm<sup>2</sup>の電線を結線し、多くの用途に対応します。

**d. アルミニウムマグネットワイヤ向けAMPLIVARスプライス**

最大3本のアルミニウムマグネットワイヤと1本の銅リードより線(全体で400~1500CMA)を1つのスプライスに同時に結線でき、効率的な接続を実現します。

**e. Economy Power 2.5テープおよびリールヘッダ**

コネクタのカラーキーイングに対応し、異なるカラーオプションを持つ複数のヘッダを同じ基板に実装する際の誤嵌合を防止します。

**f. GRACE INERTIA 2.5テープおよびリールヘッダ**

大量のプリント基板の自動実装に対応し、人件費の削減に貢献します。新しいパッケージングオプションで、生産性を向上します。

**g. TPA付きスタンダードパワータイマーハウジング**

さまざまなアプリケーションでプリント基板への一次電源供給をサポートします。それぞれ結線するよりも迅速に組み立てることが可能で、作業性の良いソリューションを実現します。

**h. 低コストの表面バーナーハウジング**

ハウジングの側面の保持用リップは、さまざまな構成のクリップに容易にはめ込むことができ、複数の設計要件に対応します。

**i. 250シリーズMini FASTONリセプタクル**

狭い空間に収まる、ミニチュアサイズのストレート構成を採用しました。標準的な0.250 × 0.032インチタブと嵌合します。

**j. V-0グローファイヤ材質のシグナルダブルロックコネクタ**

IEC 60335-1第5版のグローファイヤ試験の要件、UL 94 V-0定格要件(ナイロンPA66)を満たします。

**k. 250耐熱ポジティブブロックリセプタクルハウジング**

低挿入力を実現し、作業性を向上します。最高250℃の温度で動作します。耐熱ハウジングは240℃で動作します。



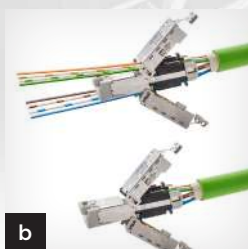
ファクトリー

# オートメーション

生産環境の自動化と分散化が進むにつれて、最小の接続さえもが実は欠かすことができない極めて重要な役割を担っています。TEは、生産のあらゆる箇所(回路基板のプロセスを最適化する各種機械から最も過酷な環境となる工場の現場)に於いて、電力を供給し、制御する革新的な接続ソリューションを提供します。



a



b



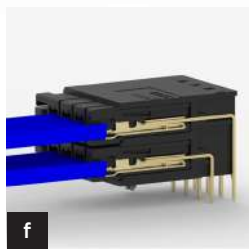
c



d



e



f



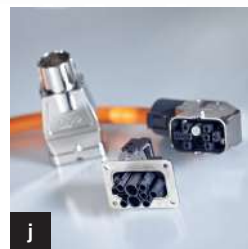
g



h



i



j

**a. プラチナ温度センサ**

-200~+600℃の極限温度環境で高い精度を実現します。線形に近い出力で、設計の効率の向上に貢献します。

**b. インダストリアルIP20 RJ45 Cat. 6Aプラグ**

内蔵された自動ワイヤ切断機能により、エラーのない取り付けを実現します。工具不要で結線処理が可能なシングルピースの共通芯線Cat. 6Aプラグにより、取り付け時間を短縮します。

**c. マイクロモータコネクタ**

パワーとブレーキを1つのコネクタに組み合わせることで、低コストを実現します。市販のケーブルアセンブリに対応した、簡単に取り付けられるコネクタで、取り付け時間を最小限に抑えます。

**d. マグネット一体型インダストリアルRJ45ジャック**

厚めの金めっき(50マイクロインチ(1.27μm)のニッケルに厚さ30マイクロインチ(0.76μm)の金めっき)により耐腐食性を向上し、製品寿命を通じて機器の電気的問題を減らします。仕様の改善により、標準的な温度範囲が特定の産業機器の要件に対応します(0~70℃)。

**e. 回転可能なデジタルディスプレイを備えたM5800トランスデューサ**

取り付けが容易で、310°回転可能なデジタルLEDディスプレイにより、圧力値を簡単に読み取ることができます。圧力範囲、圧力フィッティング、アナログ出力、電気接続の柔軟な構成が可能です。

**f. ダイナミックシリーズD-3200 (First Mate Last Break) コネクタ**

電源接続前にアースを確立し、電源接続が遮断される(FMLB)までアースを維持することで、接続の安全性を高めます。複数の接点を持つ設計により、非常に安定した電気的および機械的接続を実現し、低挿入力を可能にします。

**g. M8/M12パネルマウントPCBコネクタ**

幅広いポートフォリオと多数の構成で、PCBの設計の柔軟性を最大限に高めます。過酷な産業環境での使用に適した堅牢で費用対効果の高いコネクタです。

**h. 5600/U5600ワイヤレス圧カトランスデューサ**

計器からの信号の無線伝送が可能で、ソフトウェアプロトコルを作成し、Bluetooth®通信によりアプリケーションの要件に対応できます。

**i. サーモカップルコネクタKタイプ**

過酷な産業環境や振動の多い環境で、確実な接続を実現します。キーイングインタフェースにより、不整合を防止します。

**j. Motormanシュラウド**

補正範囲全体で総合精度(TEB)が±2.5% FSの完全校正済みの温度補償センサで、省スペースを実現します。高分解能のデジタル出力で、0~1 psiから30psiまでの絶対圧、ゲージ圧、差圧、複合圧を測定できます。

データ

# コミュニケーション

世界を行き交う情報量が劇的に増加し、より高密度でより高速な通信に対応するデバイスとシステムに対するニーズが高まっています。TEはコネクタ及びケーブルのリーディングカンパニーとして、お客様の設計にお使いいただける製品を提供します。TEは、各種規格、プロトコル、シグナルコネクティブティに関するノウハウ、データ通信に於ける接続にお使いいただける豊富な製品を取り揃えています。



**a. M2M MiMo LTEアンテナ  
レンジ**

現行のすべてのセルラーバンドとLTEバンド(698~960MHzおよび1710~3800MHz)に対応し、M2MまたはIoT向けのMiMoセルラー/LTEアンテナ機能で、すべての無線ニーズを管理します。オプションのGPS/GNSS/Galileo/Glonassアンテナによる追跡機能が含まれます。

**b. CFP2/CFP4プラグابل/O  
コネクタ**

小さなスペースで1レーンあたり最大28Gbpsの伝送を実現します。これは、現行のCFP製品の2.8倍の伝送速度です。業界トップクラスのシグナルインテグリティ(SI)性能を実現します。

**c. DDR4 SO DIMMメモリ  
ソケット**

高性能と低消費電力を同時に実現します。DDR3 SO DIMMメモリソケットよりもDIMM容量が増加しています。

**d. LGA 3647ソケットおよび  
ハードウェア**

Intelの次世代のCPUプロセッサに対応したLGA 3647ソケットおよびハードウェアで、将来のニーズに対応します。

**e. 高密度カードエッジパワー  
コネクタ**

端子あたり25Aの高電流密度と、5.08mmのピッチ、0.4mΩ平均の低接触抵抗を実現します。

**f. ChipConnect内部フェース  
プレート対プロセッサケーブル  
アセンブリ**

最新のIntel CPUプロセッサデザインに必要です。システムの設計を簡略化し、コスト削減に貢献します。

**g. Nano-Pitch I/Oリセプタクル**

SASおよびPCIe規格に対応した唯一のコネクタです。これまでの内部コネクタよりも速いデータ転送速度を実現します。

**h. マグネット一体型インダストリアルRJ45ジャック**

厚めの金めっき(50マイクロインチ(1.27μm)のニッケルに厚さ30マイクロインチ(0.76μm)の金めっき)により耐腐食性を向上し、製品寿命を通じて機器の電気的問題を減らします。仕様の改善により、標準的な温度範囲が特定の産業機器の要件に対応します(0~70°C)。

**i. SLIVERハイスピード・ケーブル  
コネクタ**

アプリケーション、データ速度、プロトコルで究極の柔軟性を実現します。0.6mmの接点ピッチにより、省スペースを実現します。

**j. OCF向けバスパワーコネクタ  
およびケーブルアセンブリ**

Open Compute Project (OCP)用途向けに設計されています。接触抵抗を減らし、低消費電力を実現します。

**k. Intel Omni-Path  
Architecture対応のzSFP+  
ケーブルおよびコネクタ**

従来の3倍の密度を持つzQSFP+は、両面基板接続ケーブルおよびコネクタで、100Gbpsおよび200Gbpsの伝送速度を実現します。高密度I/Oポートを備え、高スループットのシリコンチップに対応します。

**l. SFP28/QSFP28ケーブル  
アセンブリ**

シグナルインテグリティのノウハウを活かして、性能を向上しました。ソリューションにはケーブルアセンブリ、コネクタ、ケージが含まれます。

**m. CDFPコネクタ、ケージ、  
ケーブルアセンブリ**

市場最高クラスのポート密度と帯域幅密度により、高速伝送を実現します。双方向のデータ転送が可能な16本のレーンで、スペースを効率的に使用します。

**n. 0.5mmファインピッチ雌雄同型  
コネクタ**

コネクタ同士が嵌合する雌雄同型デザインで、在庫管理を簡単にします。要求の厳しい環境でも確実に動作します。

**o. microQSFPプラグابل/O  
シングルハイケージおよび  
サーフェスマウントコネクタ**

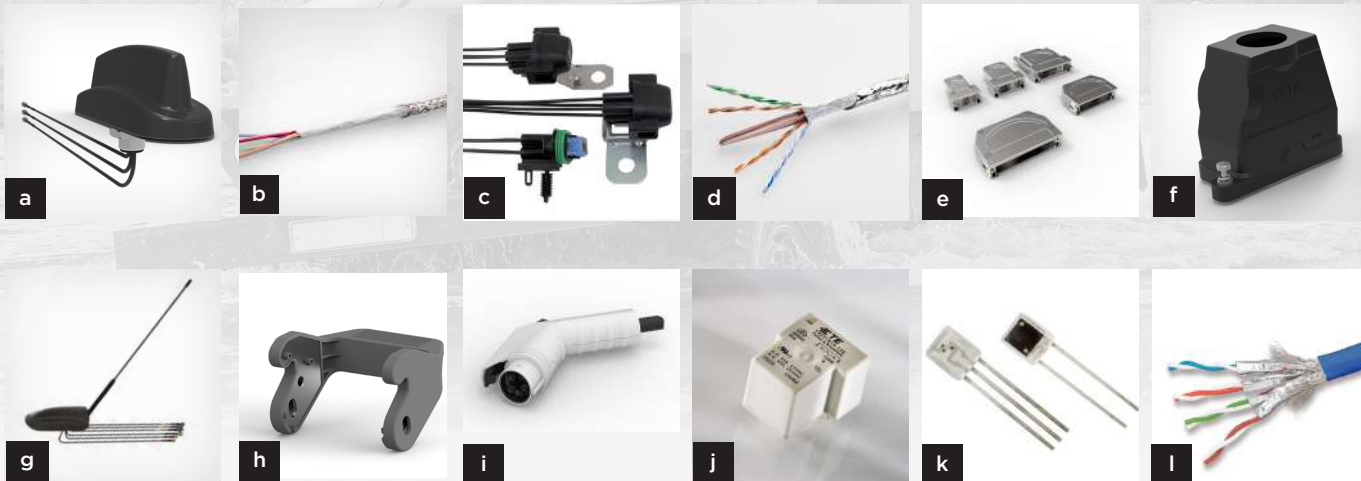
SFPとほぼ同じサイズ形状で、高密度とQSFP28の性能を実現します。ヒートシンカー一体型設計により、熱性能を向上します。



過酷な

# 環境向けソリューション

これまでになく過酷な環境下での電子部品の使用が求められています。TEの新製品は、お客様がこうしたニーズにお応えし、振動、湿気、粉塵、紫外線等に対応する製品を提供します。



**a. M2M MiMo LTEアンテナ  
レンジ**

現行のすべてのセルラーバンドとLTEバンド(698~960MHzおよび1710~3800MHz)に対応し、M2MまたはIoT向けのMiMoセルラー/LTEアンテナ機能で、すべての無線ニーズを管理します。オプションのGPS/GNSS/Galileo/Glonassアンテナによる追跡機能が含まれます。

**b. IEEE 1394アプリケーション  
対応のRaychem高速ケーブル**

独自の架橋された軽量材料を採用し、ハロゲンフリーの難燃性、耐流耐性、堅牢性、耐摩耗性を備えたチューブで、先進的な性能を実現します。

**c. 防水型ミニヒューズホルダ**

どこでもすばやく簡単に防水型ヒューズを追加できます。すぐに使える取り付けクリップを備え、複数の実装オプションに対応します。

**d. Raychem高速イーサネット  
CAT 6Aケーブル**

-55℃~+200℃の広い温度範囲で、10Gbpsの優れたシグナルインテグリティと安定した性能を実現します。過酷な環境に耐えられる設計です。

**e. 鉄道用D-Subバックシェル**

他に類を見ない360°EMI/EMCシールドを実現し、圧着オプションで振動やねじれによる破損を防ぎます。後付け可能な独自のクイックロックシステムにより、狭いスペースへの簡単で確実な実装を実現します。

**f. ヘビーデューティーコネクタ -  
IP68耐腐食性フードおよび  
ハウジング**

最長500時間の塩水噴霧試験で実証済みの耐腐食性フードとハウジングにより、過酷な環境で使用されるコネクタを保護します。衝撃や振動に強い堅牢なデザインで、ダウンタイムを減らします。

**g. 緊急サービス用MiMoアンテナ  
オプションのホイップにより、2x2  
MiMo LTEアンテナ、1x GPS、  
2x2 MiMo Wi-Fi、VHF/UHF  
(TETRA)アプリケーションに  
対応します。1穴取り付けで、車両の  
損傷、取り付け時間および費用を  
低減します。**

**h. ヘビーデューティーコネクタ -  
プラスチックロックレバー**

同一性能のステンレス鋼製に比べて低コストで、費用対効果の高い選択肢です。産業用の熱可塑性材料の採用により、腐食による不具合を低減し、製品寿命を延ばします。

**i. タイプ1向けDiBo+ EV充電  
ケーブルアセンブリ**

ハイフレックスケーブルにより、卓越した寿命、最高水準の信頼性、あらゆる動きに対応できる機能性を提供します。コネクタ ボディ内部の湿気防止および圧着部分の腐食防止を実現するデザインで、安全性を確保します。

**j. Potter & Brumfieldリレー  
T9Vシリーズ**

接点ギャップを広げることで、絶縁性を高めます。小型で、しかも高性能な40A/250VACリレーで省スペースを実現します

**k. SpO<sub>2</sub> 光コンポーネント**

赤色LEDの波長公差が最大660nm±2nmで、高い精度を実現します。優れた信頼性と品質を提供します。

**l. Cat7鉄道用データケーブル**

すべての鉄道の高速度データ伝送の要件に対応したケーブルを提供します。設計能力を拡張し、より広い帯域幅のイーサネット接続とより速い速度を実現します。

# 必要なパワーを提供 常時接続に

TEの幅広いパワーコネクタは、お客様の設計の課題に正面から対応し、常時接続に必要なパワーを提供します。TEのパワーコネクタソリューションは、スペースを最適化し、性能を最大限に高めます。

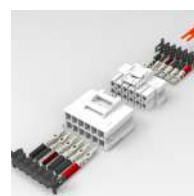
## 新製品: パワートリプルロックヘッダ

説明	型番
1X2 PCBヘッダ、ライトアングル、標準温度、キーイングA、ナチュラル	1969694-2
1X3 PCBヘッダ、ライトアングル、標準温度、キーイングA、ナチュラル	1969694-3
1X4 PCBヘッダ、ライトアングル、標準温度、キーイングA、ナチュラル	1969694-4
1X5 PCBヘッダ、ライトアングル、標準温度、キーイングA、ナチュラル	1969694-5
1X2 PCBヘッダ、ライトアングル、高温、キーイングA、グレー	1-1969694-2
1X3 PCBヘッダ、ライトアングル、高温、キーイングA、グレー	1-1969694-3
1X4 PCBヘッダ、ライトアングル、高温、キーイングA、グレー	1-1969694-4
1X5 PCBヘッダ、ライトアングル、高温、キーイングA、グレー	1-1969694-5
1X2 PCBヘッダ、水平、標準温度、キーイングA、ナチュラル	1969688-2
1X3 PCBヘッダ、水平、標準温度、キーイングA、ナチュラル	1969688-3
1X4 PCBヘッダ、水平、標準温度、キーイングA、ナチュラル	1969688-4
1X5 PCBヘッダ、水平、標準温度、キーイングA、ナチュラル	1969688-5

## 3重のロック機構で高い信頼性を実現:

- ヘッダ(キャップ)とプラグの嵌合をカチッという音で確認でき、組み立てがスムーズです。
- オプションのコネクタ位置保証(CPA)デバイスにより、コネクタの嵌合を維持します。
- ハウジング内の端子の位置を固定します。また、オプションのダブルロックプレート(TPA)の使用により、端子の抜けを防ぎます。
- ライトアングルヘッダのリテーナーにより、はんだ付け前でも基板に固定されます。
- 複数の実装オプションにより、設計の柔軟性を高めます。
- UL認定、VDE認証を含む各種規格に対応しており、最終製品の承認取得が容易です。
- 電線の絡みを防ぐ設計です。

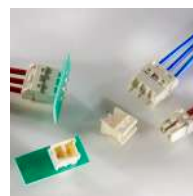
## その他のパワーコネクタの 資料



**パワートリプル  
ロックコネクタ・  
クイックリファレンス  
ガイド**



**パワーダブル  
ロックコネクタ・  
クイックリファレンス  
ガイド**



**GRACE INERTIA  
コネクタ・クイック  
リファレンスガイド**



**パワーキー  
コネクタ・クイック  
リファレンスガイド**



**Economy Power  
コネクタ・クイック  
リファレンスガイド**



**パワーコネクタ  
比較表**

# 革新的ソリューション

新規のシステム設計、既存設計の強化等を問わず、TEは電気機械部品および電子部品の課題に対するソリューションを提供します。



## 端子&スプライス

コスト削減と生産性の向上に貢献する端子とスプライス



## ドローン

最先端のドローン技術



## リレー

アプリケーションの信頼性と生産性の向上に貢献



## スマートホーム

スマートホーム用途のビジョンを実現



## パワー

TEの豊富なパワー製品で設計ソリューションを促進



## ウェアラブルデバイス

ウェアラブルデバイスのエンドツーエンドの接続性



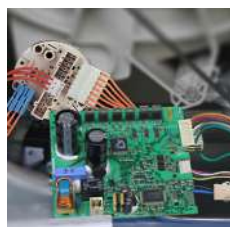
## コミュニケーション I/O

さまざまな市場のニーズに適合し、寸法やデータレート等の課題の解決をお手伝い



## モーション&ドライブ

システムの信頼性を高めると同時に、動力をセーブして費用の削減に貢献



## サブシステム設計

主要産業の最終製品をサポート



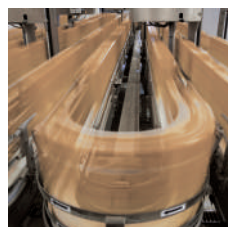
## インダストリアルコントロール

迅速に設置可能且つお客様にご評価いただいている高信頼性を有する製品



## ビルディングセーフティ&セキュリティ

日々深化するインテリジェントビルのトレンドを先取り



## マテリアルハンドリング

システムのメンテナンス時間を抑え、ダウンタイムを短縮



## ポータブル&ハンドヘルドデバイス

より速いデータ速度、強化された保護、より小さいパッケージングにスムーズに移行

© 2018 TE Connectivity Ltd. family of companies.  
本文書に関する権利はすべてTE Connectivityに帰属します。

1-1773840-2 CM PL 04/2018 Rev 6

AmbiMate, LIGHT-N-LOK, CoolSplice, SlimSeal, FASTON, LUMAWISE, NECTOR, BUCHANAN, WireMate, ALCOSWITCH, Corcom, POWER TRIPLE LOCK, Potter & Brumfield, AMPLIVAR, GRACE INERTIA, Positive Lock, Motorman, ChipConnect, Raychem, TE ConnectivityおよびTE connectivity (ロゴ)は商標です。本書で言及したその他のロゴ、製品および会社名は各社の商標である場合があります。

TE Connectivity は、本カタログに正確な情報を記載するべく可能な限りの努力を払っておりますが、情報に間違いがないことを保証するものではなく、また、情報が正確で、誤りがなく、信頼性があり、最新の内容であることを表明したり保証するものでもありません。本カタログに記載されている製品情報は、参照用のものであり、予告なく変更されることがあります。これらの変更・更新により生じた、いかなる付随的、派生的または間接的な損害に関しても、当社は責任を負いかねます。最新の寸法や設計上の仕様については、当社営業部までお問い合わせください。



**KYORITSU**  
**協立電業株式会社**

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5  
TEL: 042-548-8881 (代)  
FAX: 042-548-9101 (代)